

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-246445

(43)Date of publication of application : 30.08.2002

(51)Int.Cl.

H01L 21/68
C23C 16/44
H01L 21/22
H01L 21/31

(21)Application number : 2001-040379

(71)Applicant : HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC

(22)Date of filing : 16.02.2001

(72)Inventor : ISHIZUKA TAKAHARU

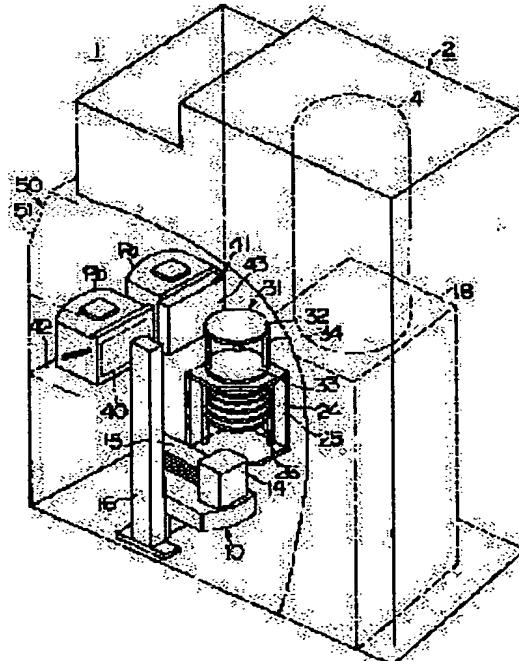
NOTO KOICHI
MATSUNAGA TATSUHISA

(54) SUBSTRATE PROCESSOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To arrange a dummy wafer stocker and a wafer-positioning device in a casing.

SOLUTION: The wafer-positioning device 24 for adjusting notches, formed in a product wafer Wb in a plurality of product wafers is installed in the casing 2. A wafer stocker 31, keeping a plurality of dummy wafers Wa, is overlapped and arranged on the box unit 25 of the wafer-positioning device 24. Since the occupancy space on plane can be reduced by arranging the wafer stocker on the wafer positioning device, the wafer stocker and the wafer-positioning device can be disposed at the periphery of a wafer transfer device in the casing. A load locking chamber 18 can be constructed in the casing.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-246445

(P2002-246445A)

(43)公開日 平成14年8月30日(2002.8.30)

(51)Int.Cl.⁷
H 01 L 21/68

識別記号

F I
H 01 L 21/68

テマコード*(参考)
M 4 K 0 3 0

C 23 C 16/44
H 01 L 21/22
21/31

5 1 1

C 23 C 16/44
H 01 L 21/22
21/31

T 5 F 0 3 1
F 5 F 0 4 5
5 1 1 J
E

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全10頁)

(21)出願番号 特願2001-40379(P2001-40379)

(22)出願日 平成13年2月16日(2001.2.16)

(71)出願人 000001122

株式会社日立国際電気

東京都中野区東中野三丁目14番20号

(72)発明者 石塚 隆治

東京都中野区東中野三丁目14番20号 株式会社日立国際電気内

(72)発明者 能戸 幸一

東京都中野区東中野三丁目14番20号 株式会社日立国際電気内

(74)代理人 100085637

弁理士 梶原 辰也

最終頁に続く

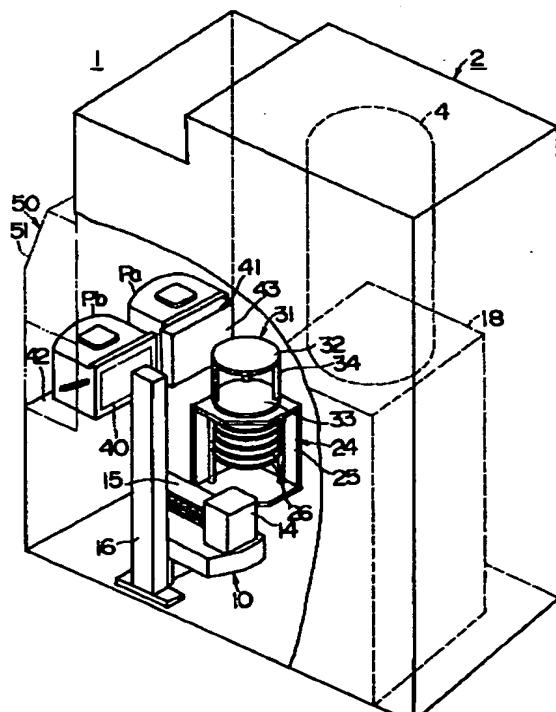
(54)【発明の名称】 基板処理装置

(57)【要約】

【課題】 筐体にダミーウエハストッカとウエハ位置合わせ装置を併置する。

【解決手段】 プロダクトウエハW bに形成されたノッチを複数枚のプロダクトウエハ相互間で揃えるウエハ位置合わせ装置2 4が筐体2の内部に設置されており、ウエハ位置合わせ装置2 4の箱体2 5の上には複数枚のダミーウエハW aを保管するウエハストッカ3 1が重ねて設置されている。

【効果】 ウエハストッカがウエハ位置合わせ装置の上に設置されることにより、平面上の占拠スペースを減少できるため、ウエハストッカとウエハ位置合わせ装置の両方を筐体内部のウエハ移載装置の周囲に設置できる。また、筐体内部にロードロックチャンバ1 8を構築できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板に形成された基準位置表示部を基板の周方向の所定の位置に合わせる基板位置合わせ装置と、製品基板以外の基板を格納する基板ストッカとが垂直方向に配置されていることを特徴とする基板処理装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、基板処理装置、特に、比較的に小数枚の基板をバッチ処理するためのものに関し、例えば、半導体素子を含む半導体集積回路が作り込まれる半導体ウエハ（以下、ウエハという。）に不純物を拡散したり絶縁膜や金属膜等のCVD膜を形成したりする拡散・CVD装置を利用して有効なものに関する。

【0002】

【従来の技術】 半導体装置の製造方法において、ウエハに不純物を拡散したり絶縁膜や金属膜等のCVD膜を形成したりする工程には、バッチ式縦形拡散・CVD装置（以下、バッチ式CVD装置という。）が使用されている。

【0003】 ところで、バッチ式CVD装置を含む基板処理装置において被処理基板である複数枚のウエハを収納して搬送するためのキャリア（ウエハ収納容器）としては、互いに対向する一対の面が開口された略立方体の箱形状に形成されているカセットと、一つの面が開口された略立方体の箱形状に形成され開口面にキャップが着脱自在に装着されているFOUP（front opening unified pod。以下、ポッドという。）とがある。ウエハのキャリアとしてポッドが使用される場合には、ウエハが密閉された状態で搬送されることになるため、周囲の雰囲気にパーティクル等が存在していたとしてもウエハの清浄度は維持することができる。したがって、基板処理装置が設置されるクリーンルーム内の清浄度をあまり高く設定する必要がなくなるため、クリーンルームに要するコストを低減することができる。そこで、最近のバッチ式CVD装置においては、ウエハのキャリアとしてポッドが使用されて来ている。

【0004】 ウエハのキャリアとしてポッドを使用したバッチ式CVD装置として、ウエハに所望の処理を施すプロセスチューブと、多数枚（例えば、百五十枚）のウエハを保持してプロセスチューブに搬入搬出するポートと、ウエハがポートの間でウエハ移載装置によって授受されるウエハ授受ポートと、ポッドが置かれるポッドステージと、ポッドを一時的に保管するポッド棚と、ポッドをポッドステージとポッド棚との間およびポッド棚とウエハ授受ポートとの間で搬送するポッド搬送装置とを備えており、次のように作用するものがある。

【0005】 すなわち、このバッチ式CVD装置において、ポッドはポッドステージに供給され、ポッド搬送装

置によってポッド棚に搬送されて一時的に保管される。ポッド棚に保管されたポッドは複数台がポッド搬送装置によってウエハ授受ポートに繰り返し搬送される。ウエハ授受ポートに搬送されたポッドのウエハは多数枚が、ポートにウエハ移載装置によって装填（チャージング）される。ポートに装填されたウエハはポートによってプロセスチューブに搬入（ローディング）され、プロセスチューブによって所望の処理を施される。処理されたウエハはポートによってプロセスチューブから搬出（アンローディング）される。処理済みの多数枚のウエハはポートからウエハ移載装置によって繰り返しディスチャージングされ、ウエハ授受ポートの複数台の空のポッドに繰り返し戻される。処理済みのウエハを収納されたポッドはポッド搬送装置によってポッド棚に一時的に保管された後に、ポッドステージに繰り返し搬送される。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 最近のシステムLSI等の生産に当たっては、一回の処理枚数が二十五枚以下という小バッチのバッチ式CVD装置が必要になって来ている。この小バッチのバッチ式CVD装置においては、一回のバッチに供給するポッドの数は二個～三個も有ればよい。しかしながら、前記したバッチ式CVD装置は一回の処理枚数が百五十枚程度の大バッチのためのものであり、ポッド棚の投影床面積や段数を大きく設定したりポッド棚を回転構造に構築したりすることにより、ポッド棚におけるポッドの保管数が増加されているため、小バッチのバッチ式CVD装置に転用したのでは、全体が大形化したり構造が複雑化したりすることにより、イニシャルコストやランニングコストが増加するという問題点がある。

【0007】 また、小バッチ式CVD装置においても、サイドダミーウエハやモニタウエハが使用されるので、これらのウエハを格納しておくためのウエハストッカを設置する必要がある。さらに、小バッチ式CVD装置においても、ウエハの結晶の方位を示すのにウエハの外周部にV字形状に切り欠かれたノッチ（基準位置表示部）を複数枚のウエハ相互間で揃えるためのウエハ位置合わせ装置（基板位置合わせ装置）も設置する必要がある。しかしながら、ウエハ移載装置の周囲にはウエハ格納用のウエハストッカとウエハ位置合わせ装置とを設置するスペースは無いという問題点がある。特に、小バッチ式CVD装置においてロードロック構造を採用した場合には、ロッドチャンバとこれの気密室を開閉するためのゲートとが設備されるために、スペース上の問題点はより一層顕著になる。

【0008】 本発明の目的は、少数枚の基板を取り扱うのに好適でコストを低減することができるとともに、基板格納用の基板ストッカや基板位置合わせ装置を設置することができる基板処理装置を提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明に係る基板処理装置は、基板に形成された基準位置表示部を基板の周方向の所定の位置に合わせる基板位置合わせ装置と、製品基板以外の基板を格納する基板ストッカとが垂直方向に配置されていることを特徴とする。

【0010】前記した手段によれば、基板位置合わせ装置と基板ストッカとが垂直方向に配置されているため、平面上の占拠スペースを減少することができる。すなわち、基板処理装置における平面上の占拠スペースを小さく抑えつつ基板位置合わせ装置と基板ストッカとの両方を基板移載装置等の周囲に設置することができる。

【0011】

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態を図面に即して説明する。

【0012】本実施の形態において、本発明に係る基板処理装置は、一回のバッチ処理の枚数が五十枚程度以下の小バッチを取り扱うバッチ式CVD装置すなわち小バッチ式縦形拡散・CVD装置（以下、小バッチ式CVD装置という。）として構成されている。この小バッチ式CVD装置1は製品基板としてはプロダクトウエハを取り扱うものとして構成されており、製品基板用キャリアとしてはポッドを取り扱うものとして構成されている。なお、以下の説明において、前後左右は図3を基準とする。すなわち、ポッドオープナ41側が前側、その反対側すなわちロードロックチャンバ18側が後側、クリーンユニット17側が左側、その反対側すなわちウエハ移載装置10側が右側とする。

【0013】図1～図4に示されているように、小バッチ式CVD装置1は筐体2を備えている。筐体2内の後端部の上部にはヒータユニット3が垂直方向に据え付けられており、ヒータユニット3の内部には上端が閉塞し下端が開口した円筒形状のプロセスチューブ4が同心円に配置されている。プロセスチューブ4にはプロセスチューブ4の円筒中空部によって形成された処理室に原料ガスやバージガス等を導入するためのガス導入管5と、プロセスチューブ4の内部を真空排気するための排気管6とが接続されている。

【0014】筐体2の後端部の下部には送りねじ装置等によって構成されたエレベータ7が設置されており、エレベータ7はプロセスチューブ4の真下に水平に配置されたシールキャップ8を垂直方向に昇降させるように構成されている。シールキャップ8はプロセスチューブ4の炉口である下端開口をシールするように構成されるとともに、ポート9を垂直に支持するように構成されている。ポート9は基板としてのウエハWを複数枚（例えば、五十枚程度以下）、中心を揃えて水平に配置した状態で支持して、プロセスチューブ4の処理室に対してエレベータ7によるシールキャップ8の昇降に伴って搬入搬出するように構成されている。

【0015】図2、図3および図4に示されているよう

に、筐体2内の前側領域にはポート9に対してウエハWをチャージングおよびディスチャージングするウエハ移載装置10が設置されている。ウエハ移載装置10はロータリーアクチュエータ11を備えており、ロータリーアクチュエータ11は上面に設置された第一リニアアクチュエータ12を水平面内で回転させるように構成されている。第一リニアアクチュエータ12の上面には第二リニアアクチュエータ13が設置されており、第一リニアアクチュエータ12は第二リニアアクチュエータ13を水平移動させるように構成されている。第二リニアアクチュエータ13の上面には移動台14が設置されており、第二リニアアクチュエータ13は移動台14を水平移動させるように構成されている。移動台14にはウエハWを下から支持するツィーザ15が複数枚（本実施の形態においては五枚）、等間隔に配置されて水平に取り付けられている。ウエハ移載装置10は送りねじ機構によって構成されたエレベータ16によって昇降されるようになっている。

【0016】図3に示されているように、筐体2の内部における前部の左側壁にはクリーンエアを吹き出すクリーンユニット17が設置されている。また、図2～図4に示されているように、筐体2の内部の後部にはロードロックチャンバ18が、シールキャップ8に支持されたポート9およびエレベータ7を取り囲むように構築されている。ロードロックチャンバ18のウエハ移載装置10と対向する前面壁には、ゲート20によって開閉されるウエハ搬入搬出口19が開設されている。ロードロックチャンバ18の後面壁には、保守点検等に際してポート9をロードロックチャンバ18の内部に対して出し入れするためのポート搬入搬出口21が開設されており、通常時には、ポート搬入搬出口21はゲート22によって閉塞されている。図3に示されているように、ロードロックチャンバ18には排気管23が接続されており、ロードロックチャンバ18の内部は排気管23によって所定の圧力に維持されるようになっている。

【0017】図2および図3に示されているように、筐体2の内部のクリーンユニット17とウエハ移載装置10との間には、図5に示されたウエハ位置合わせ装置24が設置されている。ウエハ位置合わせ装置24はウエハの結晶の方位を示すのにウエハに形成された基準位置表示部としてのノッチを複数枚のウエハ同士間で揃えるための位置合わせ装置である。図5に示されているように、ウエハ位置合わせ装置24は一つのコーナ部が切り欠かれた正方形の箱形状に形成された箱体25と、箱体25の内部に回転中心を同一の垂直線に一致された状態で回転自在に支承された五枚のターンテーブル26と、各ターンテーブル26を独立して回転駆動するモータ27およびタイミングベルト28と、ウエハの外周部を支持するために各ターンテーブル26の周方向に120度間隔に分散配置された支持ピン29と、箱体25のウエ

ハ投入口と反対側に設置されてノッチを検出する光学センサ30とを備えている。

【0018】図2、図3および図5に示されているように、ウエハ位置合わせ装置24の筐体25の上にはサイドダミーウエハ（以下、ダミーウエハという。）を格納しておくためのウエハストッカ31が設置されている。ウエハストッカ31はポート9と同様の構成を備えており、複数枚（例えば、五枚～二十枚程度）のダミーウエハを保管し得るように構成されている。すなわち、図5に示されているように、ウエハストッカ31は上側端板32および下側端板33と、上側端板32と下側端板33との間に垂直に立脚された三本の保持部材34と、三本の保持部材34に軸方向に等間隔に配置されて同一水平面を構成するように刻設された複数条の保持溝35とを備えており、ウエハの外周部が同一水平面内の三条の保持溝35に挿入されることにより、ウエハを水平に保持するように構成されている。三本の保持部材34のうち一本はウエハ位置合わせ装置24のウエハ投入口と反対側に配置され、残りの二本は当該保持部材34と90度の位相差の二箇所にそれぞれ配置されている。つまり、ウエハストッカ31のウエハ投入口とウエハ位置合わせ装置24のウエハ投入口とは対応されている。

【0019】図2～図4に示されているように、筐体2の正面壁の右寄り位置にはウエハを筐体2に対して搬入搬出するためのウエハ搬入搬出口40が開設されており、ウエハ搬入搬出口40にはポッドオープナ41が設置されている。ポッドオープナ41はポッドを載置する載置台42と、載置台42に載置されたポッドのキャップを着脱するキャップ着脱機構43とを備えており、載置台42に載置されたポッドのキャップをキャップ着脱機構43によって着脱することにより、ポッドのウエハ出し入れ口を開閉するようになっている。

【0020】図2～図4に示されているように、筐体2の正面の下部におけるポッドオープナ41の載置台42の左脇にはポッドを載置するポッドステージ44が載置台42に隣接して設置されている。ポッドオープナ41の載置台42に対してはポッドが、図示しない工程内搬送装置（RGV）によって供給および排出されるようになっている。

【0021】カバー51によって被覆されているが、筐体2の正面の上部にはポッド搬送装置50が設備されており、ポッド搬送装置50はポッドオープナ41の載置台42とポッドステージ44との間でポッドをその把手を把持（クランピング）した状態で搬送するように構成されている。

【0022】以下、前記構成に係る小バッチ式CVD装置の作用を説明する。

【0023】予め、複数枚のダミーウエハWaを収納したポッド（以下、ダミーウエハ用ポッドPaという。）が、ポッドオープナ41の載置台42の上に工程内搬送

装置によって搬送されて載置される。ポッドオープナ41の載置台42の上に供給されたダミーウエハ用ポッドPaは、そのキャップをキャップ着脱機構43によって取り外されてウエハの出し入れ口を開放される。

【0024】ポッドオープナ41のダミーウエハ用ポッドPaが開放されると、ダミーウエハ用ポッドPaの複数枚のダミーウエハWaは筐体2の内部に設置されたウエハストッカ31へ、ウエハ移載装置10によって筐体2のウエハ搬入搬出口40を通して保管される。すなわち、複数枚のダミーウエハWaはウエハ移載装置10によってダミーウエハ用ポッドPaから取り出され、筐体2に開設されたウエハ搬入搬出口40を通して筐体2の内部に搬入され、筐体2の内部においてウエハ位置合わせ装置24の上に設置されたウエハストッカ31の三条の保持溝35へ挿入される。

【0025】指定された枚数のダミーウエハWaのウエハストッカ31への保管作業が完了すると、ポッドオープナ41の載置台42のダミーウエハ用ポッドPaはポッドオープナ41の載置台42からポッドステージ44の上へポッド搬送装置50によって搬送されて載置される。すなわち、ダミーウエハ用ポッドPaはポッドステージ44の上で待機する。

【0026】一方、ロードロックチャンバ18のウエハ搬入搬出口19がゲート20によって開放され、ウエハストッカ31のダミーウエハWaが複数枚ずつ、ポート9へウエハ移載装置10によってウエハ搬入搬出口19を通じて装填（チャージング）される。この際、図4に示されているように、ダミーウエハWaはポート9の上側端部および下側端部に適宜に分配されて装填される。

【0027】その後、複数枚のプロダクトウエハWbを収納したポッド（以下、プロダクトウエハ用ポッドPbという。）が、ポッドオープナ41の載置台42の上に工程内搬送装置によって搬送されて載置される。プロダクトウエハ用ポッドPbのキャップがキャップ着脱機構43によって取り外され、プロダクトウエハ用ポッドPbのウエハ出し入れ口が開放される。

【0028】ポッドオープナ41のプロダクトウエハ用ポッドPbが開放されると、プロダクトウエハWbは筐体2の内部に設置されたウエハ位置合わせ装置24へ、ウエハ移載装置10によって筐体2のウエハ搬入搬出口40を通して装填される。すなわち、プロダクトウエハWbはウエハ移載装置10によってプロダクトウエハ用ポッドPbから取り出され、筐体2に開設されたウエハ搬入搬出口40を通して筐体2の内部に搬入され、筐体2の内部に設置されたウエハ位置合わせ装置24の筐体25に挿入されターンテーブル26の上に載置される。

【0029】五枚のプロダクトウエハWbが装填されると、ウエハ位置合わせ装置24はプロダクトウエハWbをターンテーブル26によって回転させながら、プロダクトウエハWbに形成されたノッチを光学センサ30に

よって検出し、ターンテーブル26と支持ピン29とが協働して五枚のプロダクトウエハWb相互のノッチを揃える。

【0030】五枚のプロダクトウエハWb相互のノッチの位置がウエハ位置合わせ装置24によって揃えられると、ロードロックチャンバ18のウエハ搬入搬出口19がゲート20によって開放され、ウエハ位置合わせ装置24のプロダクトウエハWbはポート9へウエハ移載装置10によってウエハ搬入搬出口19を通じて装填されて行く。この際、図4に示されているように、プロダクトウエハWbはポート9の上側端部および下側端部に分配されて装填されたダミーウエハWa群の間に適宜に装填される。

【0031】以上のプロダクトウエハWbのプロダクトウエハ用ポッドPbからウエハ位置合わせ装置24への装填作業、ウエハ位置合わせ装置24の位置合わせ作業およびウエハ位置合わせ装置24からポート9への装填作業が繰り返されることにより、予め指定された枚数

(ここでは二十五枚)のプロダクトウエハWbがポート9へ装填されると、ウエハ搬入搬出口19はゲート20によって閉鎖され、ロードロックチャンバ18はロードロックされる。

【0032】他方、全てのプロダクトウエハWbがポート9に装填されることによって空になったプロダクトウエハ用ポッドPbは、ポッドオープナ41の載置台42の上に置かれたままの状態で待機する。

【0033】以上のようにしてダミーウエハWaおよびプロダクトウエハWbが予め指定された枚数(例えば、ダミーウエハWaとプロダクトウエハWbとを合計して三十枚~三十二枚)がポート9に移載されると、ポート9はエレベータ7によって上昇されてプロセスチューブ4の処理室に搬入される。ポート9が上限に達すると、ポート9を保持したシールキャップ8の上面の周辺部がプロセスチューブ4をシール状態に閉塞するため、処理室は気密に閉じられた状態になる。

【0034】プロセスチューブ4の処理室は気密に閉じられた状態で、所定の圧力となるように排気管6によって排気され、ヒータユニット3によって所定の温度に加熱され、所定の原料ガスがガス導入管5によって所定の流量だけ供給される。これにより、予め設定された処理条件に対応する所望の膜がプロダクトウエハWbに形成される。ここで、処理室で一度に処理するプロダクトウエハWbの枚数は、一台の製品基板用キャリアであるプロダクトウエハ用ポッドPbに収納されるプロダクトウエハ枚数以下に設定されており、一台の製品基板用キャリアであるプロダクトウエハ用ポッドPbに収納された全プロダクトウエハWbが処理室において一度に処理されるようになっている。

【0035】予め設定された処理時間が経過すると、ポート9がエレベータ7によって下降されることにより、

処理済みプロダクトウエハWbおよびダミーウエハWaを保持したポート9がウエハ移載位置に搬出される。

【0036】ポート9がウエハ移載位置に搬出されると、まず、ロードロックチャンバ18のウエハ搬入搬出口19がゲート20によって開放され、ポート9の処理済みプロダクトウエハWbがウエハ移載装置10によってディスチャージングされる。続いて、筐体2のウエハ搬入搬出口40がポッドオープナ41によって開放され、ウエハ移載装置10によってディスチャージングされた処理済のプロダクトウエハWbがポッドオープナ41の載置台42で待機している元のプロダクトウエハ用ポッドPbにウエハ搬入搬出口40を通じて収納される。

【0037】この処理済のプロダクトウエハWbのディスチャージング作業およびプロダクトウエハ用ポッドPbへの収納作業が繰り返されて、ポート9の全ての処理済みプロダクトウエハWbが空のプロダクトウエハ用ポッドPbへの収納作業が完了すると、プロダクトウエハ用ポッドPbはキャップ着脱機構43によってキャップを装着された後に、ポッドオープナ41の載置台42から次の処理工程へ工程内搬送装置によって搬送されて行く。

【0038】他方、プロダクトウエハWbと一緒に処理されたダミーウエハWaはウエハ移載装置10によってディスチャージングされ、筐体2の内部に設置されたウエハストッカ31に保管される。但し、ダミーウエハWaはポート9に装填したままにして、再使用してもよい。

【0039】以降、前述した作用が繰り返されて、プロダクトウエハWbが例えば二十五枚ずつ、小バッチ式CVD装置1によってバッチ処理されて行く。この間、ダミーウエハWaのポート9に対するチャージングおよびディスチャージングは、筐体2の内部に設置されたウエハストッカ31とロードロックチャンバ18の内部に設置されたポート9との間において実施されるため、筐体2から外部に搬出されることはない。

【0040】ところで、繰り返し処理を施されると、ダミーウエハWaには成膜の堆積や異物の付着による汚染が発生したり熱による反りが発生したりするため、更新する必要がある。そこで、ダミーウエハWaの繰り返し回数が予め設定された回数に達すると、ウエハストッカ31に保管されたダミーウエハWaは筐体2の外部に取り出されて、ダミーウエハ用ポッドPaに収納される。

【0041】すなわち、ダミーウエハWaの更新作業に際して、ポッドステージ44の空のダミーウエハ用ポッドPaがポッドステージ44からポッドオープナ41の載置台42にポッド搬送装置50によって搬送されて供給される。続いて、ダミーウエハ用ポッドPaのキャップがキャップ着脱機構43によって開放される。次いで、ウエハストッカ31の使用済みのダミーウエハWa

が空のダミーウエハ用ポッドP aへ、ウエハ移載装置10によって筐体2のウエハ搬入搬出口40を通して収納される。

【0042】使用済みのダミーウエハW aが収納されたダミーウエハ用ポッドP aはキャップ着脱機構43によって閉じられた後に、ポッドオープナ41の載置台42からダミーウエハの再生作業工程等へ工程内搬送装置によって搬送されて行く。

【0043】前記実施の形態によれば、次の効果が得られる。

【0044】1) ウエハストッカとウエハ位置合わせ装置とを垂直方向に重ねて設置することにより、平面の占拠スペースを減少させることができるために、筐体の内部におけるウエハ移載装置の周囲の狭いスペースであってもウエハストッカとウエハ位置合わせ装置と共に設置することができる。

【0045】2) ウエハストッカおよびウエハ位置合わせ装置と共にロードロックチャンバを筐体の内部に構築することにより、筐体の内部におけるプロダクトウエハおよびダミーウエハの汚染を防止することができるため、バッチ式CVD装置の処理の品質および信頼性を高めることができる。

【0046】3) 比較的軽量のウエハストッカをウエハ位置合わせ装置の上に設置することにより、ウエハ位置合わせ装置の箱体を堅牢に設定しなくても済むため、製造コストを低減することができる。

【0047】なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々に変更が可能であることはいうまでもない。

【0048】小バッチ式CVD装置は成膜処理に使用するに限らず、酸化膜形成処理や拡散処理等の処理にも使用することができる。

【0049】前記実施の形態では小バッチ式CVD装置の場合について説明したが、本発明はこれに限らず、基板処理装置全般に適用することができる。

【0050】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、筐体の内部に基板保管用の基板ストッカと基板位置合わせ装置とを設置することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態である小バッチ式CVD装置を正面側から見た斜視図である。

【図2】その背面側見た一部切断斜視図である。

【図3】その平面断面図である。

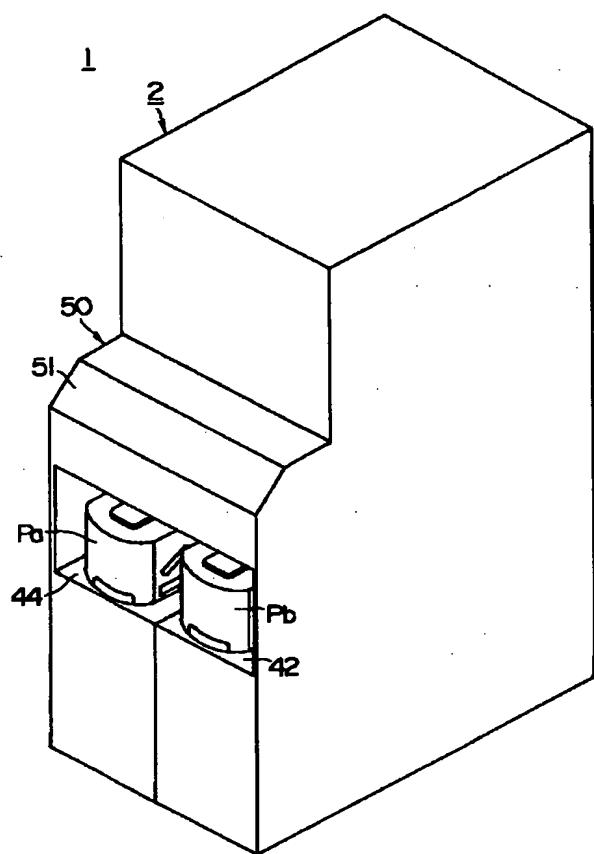
10 【図4】その側面断面図である。

【図5】ウエハ位置合わせ装置およびウエハストッカを示す斜視図である。

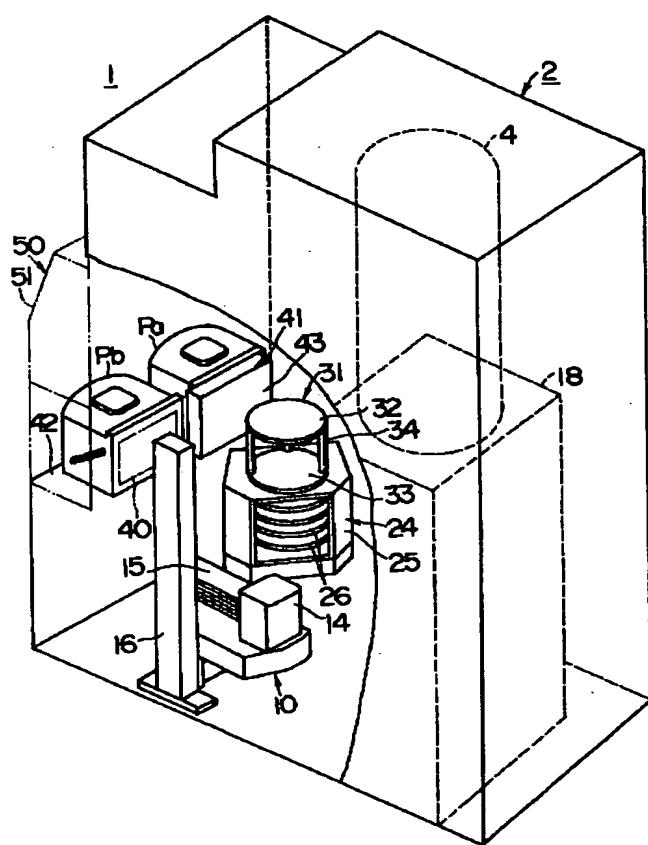
【符号の説明】

W…ウエハ（基板）、W a…ダミーウエハ（ダミー基板）、W b…プロダクトウエハ（製品基板）、P a…ダミーウエハ用ポッド、P b…プロダクトウエハ用ポッド、1…小バッチ式CVD装置（基板処理装置）、2…筐体、3…ヒータユニット、4…プロセスチューブ、5…ガス導入管、6…排気管、7…エレベータ、8…シールキャップ、9…ポート、10…ウエハ移載装置、11…ロータリーアクチュエータ、12…第一リニアアクチュエータ、13…第二リニアアクチュエータ、14…移動台、15…ツィーザ、16…エレベータ、17…クリーンユニット、18…ロードロックチャンバ、19…ウエハ搬入搬出口、20…ゲート、21…ポート搬入搬出口、22…ゲート、23…排気管、24…ウエハ位置合わせ装置（基板位置合わせ装置）、25…筐体、26…ターンテーブル、27…モータ、28…タイミングベルト、29…支持ピン、30…光学センサ、31…ウエハストッカ、32…上側端板、33…下側端板、34…保持部材、35…保持溝、40…ウエハ搬入搬出口、41…ポッドオープナ、42…載置台、43…キャップ着脱機構、44…ポッドステージ、50…ポッド搬送装置、51…カバー。

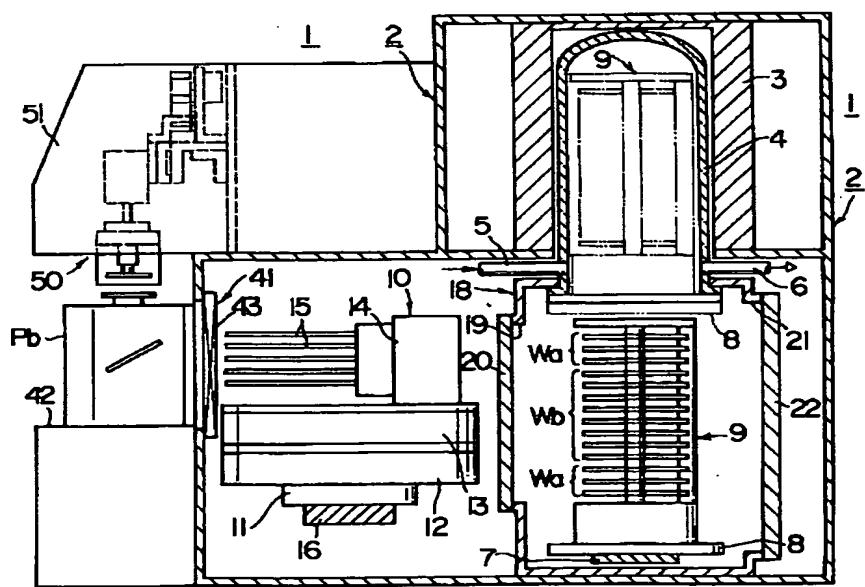
【図1】



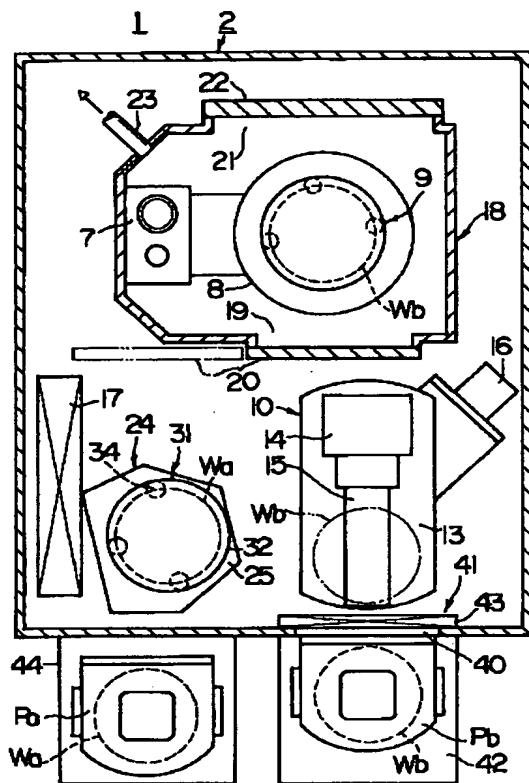
【図2】



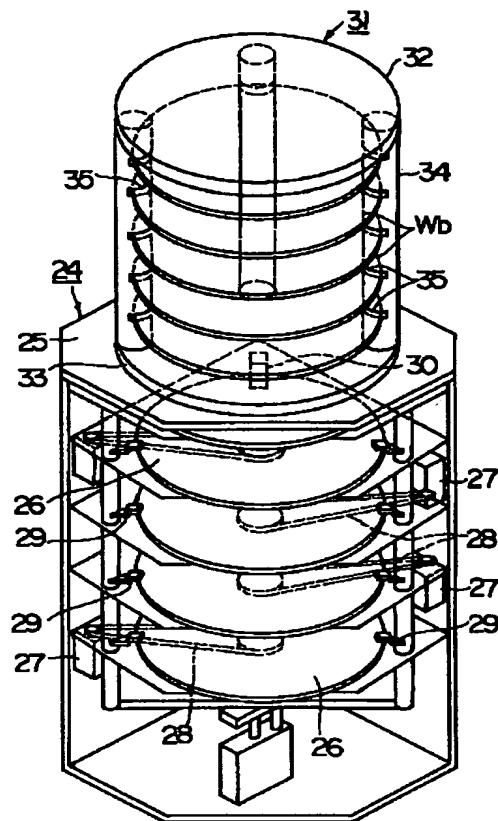
【图4】



【図3】



【図5】



【手続補正書】

【提出日】平成13年7月11日(2001.7.11)

1)

【手続補正1】

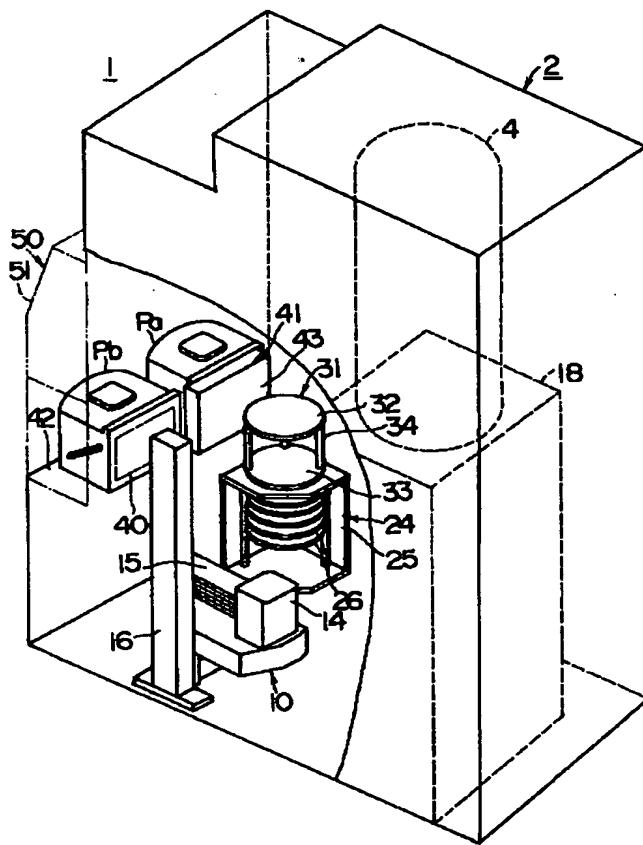
【補正対象書類名】 図面

【補正対象項目名】図2

【補正方法】変更

【補正內容】

【図2】



【手続補正2】

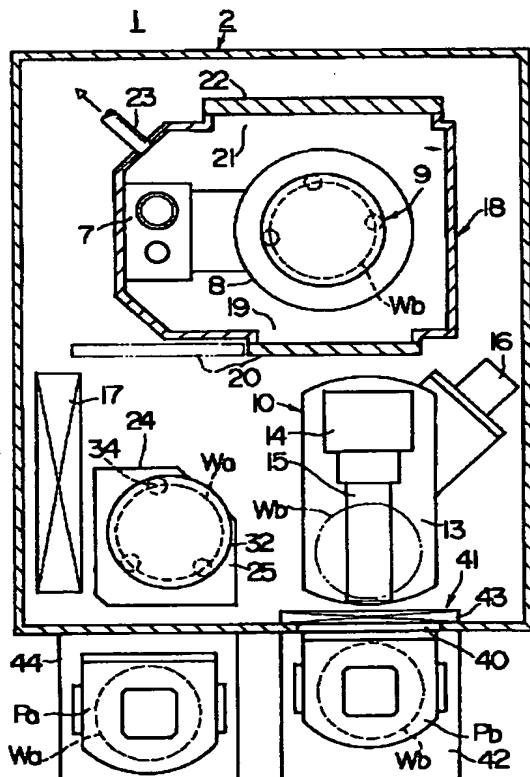
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図3

【補正方法】変更

【補正内容】

【図3】



【手続補正3】

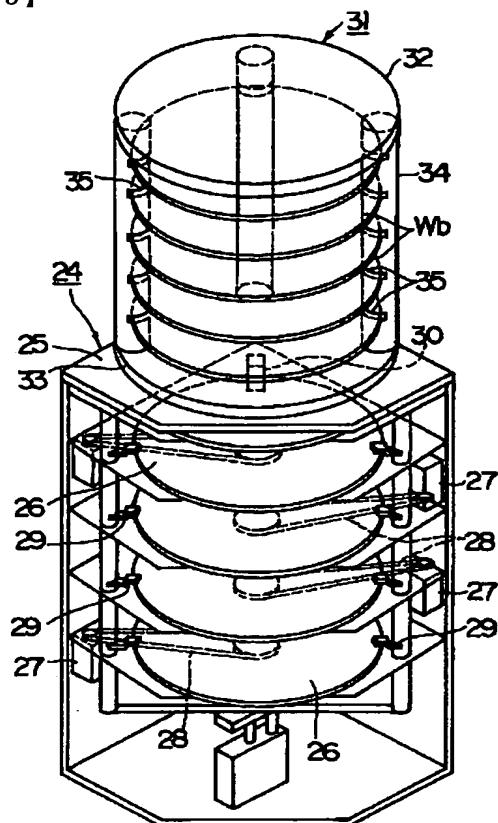
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図5

【補正方法】変更

【補正内容】

【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 松永 建久

東京都中野区東中野三丁目14番20号 株式
会社日立国際電気内

F ターム(参考) 4K030 CA04 CA12 GA13 LA15
 5F031 CA02 CA11 DA08 DA17 EA14
 FA01 FA02 FA09 FA11 FA12
 FA15 GA03 GA19 GA47 GA49
 HA33 HA42 HA59 HA67 JA02
 JA28 JA35 KA14 LA06 LA12
 MA13 MA15 MA28 NA02 NA07
 5F045 BB08 DP19 EB08 EM08 EN04
 EN05 EN06